仅供内部参考，请勿外传

电子

发布时间：2026-09-27

证券研究报告 / 行业动态报告

真武 V900 芯片发布，ECOC 收官光互联景气延续

---电子行业周报

优于大势

上次评级:优于大势

报告摘要：

AI 算力：平头哥发布真武 V900 芯片，阿里云加码 AI 算力基础设施。1）2026 杭州云栖大会（9 月 22 日-24 日）启幕，平头哥发布新一代训推一体 AI 芯片真武 V900，单芯片性能为上一代真武 M890 的 3 倍，搭载 216GB 显存、片间互联带宽 1200GB/s，原生支持 FP8/FP4 低精度，计划 2027 年一季度量产；2）9 月 23 日，AICC 2026 人工智能计算大会召开，工信部表示智能体加速落地将进一步提升算力需求；3）9 月 24 日，行云科技全资子公司签订 8.72 亿元智算资源租赁服务合同。

光通信：光互联技术密集发布，产业链产能扩张延续。1）9 月 24 日，欧洲光通信会议 ECOC 2026 收官；2）9 月 23 日，中际旭创单日耗资 7.95 亿元回购股份；3）9 月 22 日，Coherent 推出 PhotonLink 集成光学平台；4）9 月 23 日，富信科技 400G/800G 光模块 Micro TEC 实现批量供货；5）9 月 27 日，汇绿生态子公司钧恒科技拟投资 3.09 亿元建设光模块研发生产基地。

存储：长鑫科技第五代工艺平台量产，存储先进封装与 HBM 扩产提速。1）9 月 21 日，长鑫科技第五代工艺技术平台正式量产，采用四重曝光技术，内存阵列有源区半间距微缩至 11.95nm；2）9 月 22 日，佰维存储拟投资约 45 亿元建设晶圆级先进封测制造项目三期；3）9 月 23 日，三星电子计划 2027 年将 HBM4 系列产量提升一倍以上。

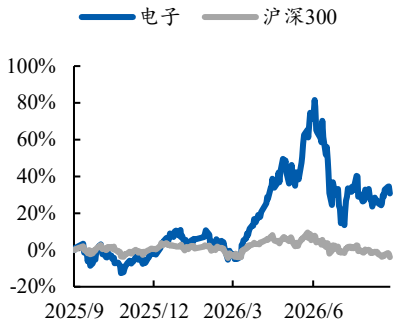
集成电路：玻璃基板与先进制程加速推进，晶圆代工价格上行。1）9 月 22 日，武汉提出将集成电路打造成为“首位产业”；2）9 月 23 日，京东方玻璃基封装载板试验线全线拉通；3）9 月 24 日，台积电拟自 2027 年 1 月起上调晶圆代工价格 3%-6%；4）9 月 23 日，高通发布两款 2nm 制程骁龙芯片；5）英伟达评估采用玻璃基板方案。

量子科技：IonQ 量子纠错与 GPU 融合研究取得进展。1）9 月 22 日，IonQ 完成业界首个端到端实时量子纠错解码器测试；2）9 月 23 日，IonQ 宣布在英伟达加速量子研究中心部署 Superion 256 量子计算机。

下周关注重点：1）产业事件：阿里云栖大会后续发布与产业合作落地，平头哥真武 V900、倚天 CPU 的供应链配套进展；2）业绩与公告：光模块、存储、半导体设备等产业链公司三季报预告陆续披露；3）存储涨价：关注存储现货与长协价格走势、HBM 扩产节奏及玻璃基板等先进封装材料的配套进展；4）先进封装：京东方玻璃基封装载板、英伟达玻璃基板方案等新路线进展；5）海外产业：台积电晶圆代工涨价落地情况、CPO/NPO 光互联技术路线演进。

风险提示：AI 算力投资不及预期风险；存储芯片价格波动；中美贸易摩擦与出口管制加剧风险；光互连技术路线切换不确定性风险。

历史收益率曲线



涨跌幅（%）	1M	3M	12M
绝对收益	3%	-22%	29%
相对收益	6%	-12%	32%

行业数据

成分股数量（只）	520
总市值（亿）	244947.58
流通市值（亿）	164877.86
市盈率（倍）	128.41
市净率（倍）	7.65
成分股总营收（亿）	43710.59
成分股总净利润（亿）	1907.60
成分股资产负债率（%）	48.76

相关报告

《昇腾 960 超节点发布，华为正式开启 NPO 元年》

--20260922

证券分析师：李玖
执业证书编号：S0550522030001
lijiu1@nesc.cn

证券分析师：武芃睿
执业证书编号：S0550522110001
wupr@nesc.cn

证券分析师：叶怡豪
执业证书编号：S0550526010002
yeyh@nesc.cn

仅供内部参考，请勿外传

目 录

1. 本周行情复盘 3
2. 本周行业重点事件 4
2.1 AI 算力：平头哥发布真武 V900 芯片，阿里云加码 AI 算力基础设施。 4
2.2 光通信：光互联技术密集发布，产业链产能扩张延续。 4
2.3 存储：长鑫科技第五代工艺平台量产，存储先进封装与 HBM 扩产提速。 5
2.4 集成电路：玻璃基板与先进制程加速推进，晶圆代工价格上行。 6
2.5 量子科技：IonQ 量子纠错与 GPU 融合研究取得进展。 6
2.6 下周关注重点 6
3. 风险提示 7

图表目录

图 1：本周申万各行业涨跌幅指数 3
图 2：申万电子细分行业本周涨跌幅情况 3

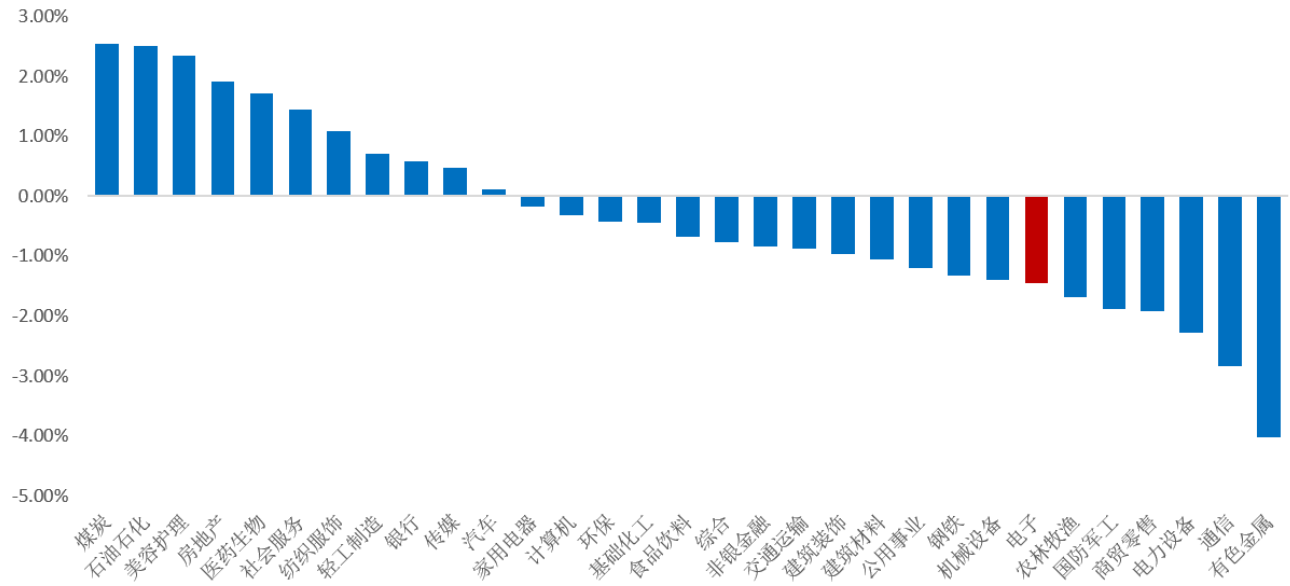
表 1：本周电子个股涨跌幅前五 4

仅供内部参考，请勿外传

1. 本周行情复盘

本周上证指数涨幅 0.33%，深证成指跌幅 0.69%，科创板综指涨幅 1.67%，创业板指跌幅 0.28%。申万电子指数周跌幅 1.46%，在 31 个子行业中排名 25。

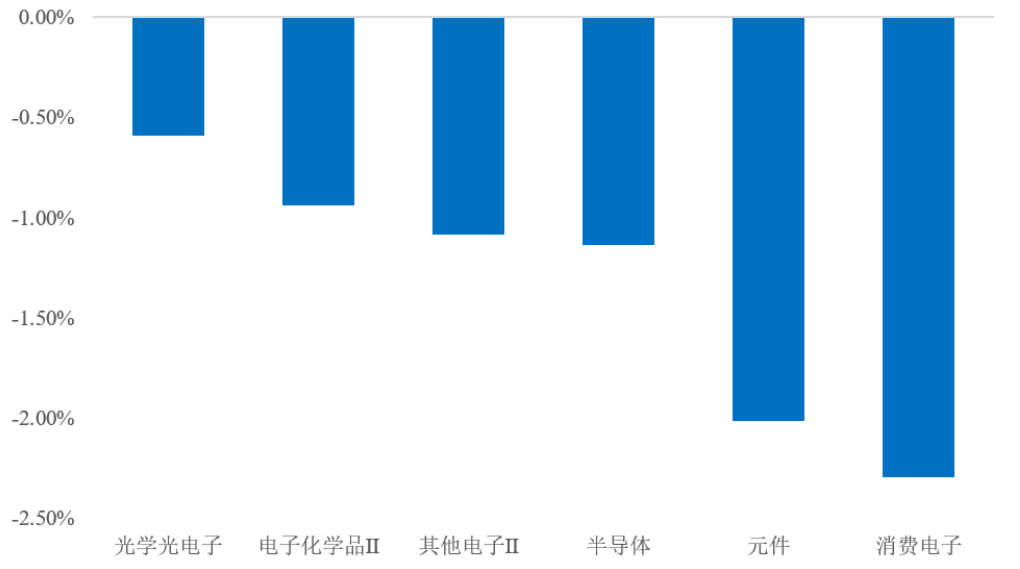
图 1：本周申万各行业涨跌幅指数



数据来源：Choice，东北证券

电子细分板块中表现前三为：光学光电子跌幅 0.59%，电子化学品II跌幅 0.94%，其他电子II跌幅 1.09%。

图 2：申万电子细分行业本周涨跌幅情况



数据来源：Choice，东北证券

个股涨幅前三为先导基电（54.14%）、福立旺（46.98%）、富信科技（38.17%）。个股跌幅前三为泓禧科技（-20.23%）、华正新材（-16.02%）、南亚新材（-14.86%）。

仅供内部参考，请勿外传

表 1：本周电子个股涨跌幅前五

	证券代码	证券名称	涨跌幅	股价（元）	公司市值（亿元）
涨幅前五	600641.SH	先导基电	54.14%	51.56	488.878
	688678.SH	福立旺	46.98%	32.63	131.5337
	688662.SH	富信科技	38.17%	128.28	147.1444
	605058.SH	澳弘电子	35.80%	60.2	86.0409
	603068.SH	博通集成	33.53%	48.51	73.632
跌幅前五	920857.BJ	泓禧科技	-20.23%	16.52	12.226
	603186.SH	华正新材	-16.02%	213.3	334.4342
	688519.SH	南亚新材	-14.86%	295.08	693.9704
	603115.SH	海星股份	-13.38%	79.4	194.1986
	300868.SZ	杰美特	-12.26%	82.84	105.3548

数据来源：Chocie，东北证券

2. 本周行业重点事件

2.1 AI 算力：平头哥发布真武 V900 芯片，阿里云加码 AI 算力基础设施。

平头哥发布新一代训推一体 AI 芯片真武 V900。2026 杭州云栖大会于 9 月 22 日至 24 日举行，平头哥在会上发布新一代训推一体 AI 芯片真武 V900，单芯片性能为上一代真武 M890 的 3 倍，搭载 216GB 显存、片间互联带宽达到 1200GB/s，原生支持 FP8/FP4 低精度，可满足万亿参数大模型的训练与推理需求，计划于 2027 年一季度量产并在阿里云数据中心规模化部署，基于其构建的单一集群可扩展至 50 万卡。此举意味着，国产 AI 芯片在算力规格、显存容量与互联带宽上持续升级，真武 V900 的低精度支持与 50 万卡集群扩展能力，为超大模型训练和推理提供了硬件底座，国产算力芯片的规模化供给能力进一步提升。

阿里云加码 AI 基础设施，平头哥构建全栈自研芯片布局。本届云栖大会上，阿里巴巴集团 CEO 吴泳铭表示，AI 模型、AI 芯片和 AI 云是机器智能时代的三大基石，阿里巴巴将坚定投入这三项基础设施建设，目标到 2032 年阿里云运营的全球数据中心规模超过 20GW。平头哥已对数据中心芯片进行全面布局，覆盖真武系列 GPU、倚天系列 CPU、磐脉系列智能网卡及 ICN 互联芯片，其中倚天服务器 CPU 将于 2027 年推出倚天 720 和倚天 730 两代产品，后续倚天 750 将支持自研 ICN 片间互联总线协议、与真武 AI 芯片直接互联。此举反映阿里在算力芯片领域的全栈自研布局进一步成型，芯片、云与模型的协同投入构成其面向机器智能时代的核心底座，云厂商的算力军备竞赛持续加剧。

AICC 2026 人工智能计算大会召开，智能体加速落地提升算力需求。9 月 23 日，AICC 2026 人工智能计算大会召开，工信部相关负责人表示，智能体加速落地将进一步提升算力需求，未来需强化算力、存力、运力、电力协同，推动计算架构、高速互联和软硬件协同等关键技术突破。此举反映智能体应用的规模化落地正成为算力需求增长的新引擎，算力基础设施的协同优化与关键技术突破成为产业发展的重点方向。

行云科技子公司签订 8.72 亿元智算资源租赁服务合同。9 月 24 日，行云科技全资子公司签订 8.72 亿元智算资源租赁服务合同，AI 算力租赁需求继续增长，公司此前亦持续通过采购 GPU 算力资源扩充算力供给能力。此举反映 AI 算力租赁市场的需求持续旺盛，第三方智算服务商通过采购算力资源扩充供给能力，算力资源向更广泛的行业客户渗透。

2.2 光通信：光互联技术密集发布，产业链产能扩张延续。

仅供内部参考，请勿外传

欧洲光通信会议 ECOC 2026 收官。9 月 24 日，欧洲光通信会议（ECOC 2026）在西班牙马拉加圆满收官，本届会议于 9 月 20 日至 24 日举行，汇聚了来自世界各地的光通信领域研究者与行业专家。此举为光通信产业的技术交流与路线演进提供平台，高速光互联、硅光、CPO/NPO 等前沿方向成为行业关注焦点。

中际旭创单日耗资 7.95 亿元回购股份。9 月 23 日，中际旭创单日耗资 7.95 亿元回购股份，共回购 85.70 万股，成交价格区间为 921.85-935 元/股，回购股份拟持作库存股份。此举反映光模块龙头在手现金充裕，持续回购用于库存股份，也体现公司对自身经营情况的判断。

Coherent 推出 PhotonLink 集成光学平台。9 月 22 日，Coherent 推出 PhotonLink 集成光学平台，面向下一代 AI 数据中心，支持 CPO、NPO 及芯片间光互联，公司预计该平台于 2026 年第四季度开始贡献收入，并同步扩大 6 英寸磷化铟产能。此举反映海外光器件龙头加速布局 CPO/NPO 等新型光互联方案，磷化铟作为光引擎核心材料的产能扩张，印证了共封装光学产业化的加速推进。

富信科技 400G/800G 光模块 Micro TEC 实现批量供货。9 月 23 日，富信科技表示，400G、800G 光模块用 Micro TEC 已实现批量供货，1.6T 产品进入小批量供货；面向 CPO 新型封装技术的 TEC 仍处于送样验证阶段。此举反映高速光模块配套的微电子制冷器件需求随速率提升而增长，光模块散热环节的国产化配套能力持续增强。

汇绿生态子公司钧恒科技拟投资 3.09 亿元建设光模块研发生产基地。9 月 27 日，汇绿生态公告，控股子公司武汉钧恒科技有限公司拟投资 3.09 亿元，在武汉东湖高新区投资建设"钧恒科技研发生产基地项目"，项目建成后现有年产 150 万支产线将实现全面技术升级，并新增年产 200 万支高速率光模块生产线，武汉区域合计达到 350 万支高速率光模块年产能。此举反映光模块产业链产能扩张延续，高速率光模块产能的扩充匹配 AI 数据中心对光互联的持续需求。

2.3 存储：长鑫科技第五代工艺平台量产，存储先进封装与 HBM 扩产提速。

长鑫科技第五代工艺技术平台正式量产，内存阵列有源区半间距微缩至 11.95nm。9 月 21 日，长鑫科技第五代工艺技术平台正式实现量产，采用四重曝光技术，将内存阵列有源区半间距微缩至 11.95nm，并同步展出基于该平台的大容量 LPDDR5X 产品。此举标志着国产 DRAM 工艺平台向更先进节点演进，四重曝光技术在先进制程受限条件下实现了存储阵列的进一步微缩，高端 DRAM 的工艺与产品竞争力持续提升。

佰维存储拟投资约 45 亿元建设晶圆级先进封测制造项目三期。9 月 22 日，佰维存储拟投资约 45 亿元建设晶圆级先进封测制造项目三期，其中固定资产投资约 40 亿元，进一步扩充存储及 AI 硬件相关晶圆级先进封装产能。此举反映存储模组厂商向晶圆级先进封装环节延伸，存储与 AI 硬件的先进封装需求持续增长，推动相关厂商加大晶圆级封测产能布局。

三星电子计划 2027 年 HBM4 系列产量提升一倍以上。9 月 23 日，据报道，三星电子计划 2027 年将 HBM4 系列产量提升一倍以上，覆盖 HBM4 及 HBM4E；为配合扩产，公司计划将关键玻璃载板采购量较今年提高约 2.5 倍，HBM 供需仍维持紧张。此举反映 HBM 供给扩张节奏加快，玻璃载板作为 HBM 先进封装的关键材料，其采购量的提升也印证了 HBM 先进封装产能的扩张，存储先进封装环节的需求确定性增强。

仅供内部参考，请勿外传

2.4 集成电路：玻璃基板与先进制程加速推进，晶圆代工价格上行。

武汉提出将集成电路打造成为“首位产业”。9 月 22 日，武汉提出加快将集成电路打造成为“首位产业”，重点深耕存储芯片、化合物半导体、传感芯片，并布局存算一体、光电融合、三维集成等前沿方向，支持长江存储等龙头企业增资扩产。此举反映地方层面对集成电路产业的政策支持力度加大，存储、化合物半导体等优势领域的集群化发展进一步强化，也为龙头企业的扩产提供政策支撑。

京东方玻璃基封装载板试验线全线拉通。9 月 23 日，京东方表示玻璃基封装载板试验线已全线拉通，完成尺寸超过 100×100mm 的 24 层基板产出，并计划未来一年内敲定玻璃基封装载板量产线投资方案。此举反映玻璃基板作为下一代先进封装材料的产业化进程加速，玻璃基封装载板在 AI 芯片高密度封装中的应用前景逐步清晰，先进封装新路线的产业化持续推进。

台积电拟自 2027 年 1 月起上调晶圆代工价格 3%-6%。9 月 24 日，据供应链消息，台积电拟自 2027 年 1 月起上调晶圆代工价格 3%-6%，其中 2nm、3nm 等先进制程涨幅较高，AI 芯片需求持续推升先进制程产能利用率及代工价格。此举反映先进制程代工供需格局偏紧，AI 芯片需求推动先进制程产能利用率维持高位，代工价格的上行也向产业链下游传导成本压力。

高通发布两款 2nm 制程骁龙芯片。9 月 23 日，高通发布两款新一代旗舰骁龙芯片，均采用 2nm 制程，CPU 最高主频达到 5GHz，进一步提升安卓高端移动终端的 CPU 及 AI 计算性能。此举反映旗舰移动 SoC 向 2nm 制程迈进，高端安卓终端的计算与 AI 性能持续升级，先进制程在移动端的渗透进一步加深。

英伟达评估采用玻璃基板方案。据韩国科技媒体 KIPOST 报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商 SCHMID 等企业开展合作，希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望在 2028 年前落地。此举反映玻璃基板在 AI 芯片先进封装中的应用前景受到头部厂商关注，若英伟达采用玻璃基板，将加速玻璃基板产业链的产业化进程。

2.5 量子科技：IonQ 量子纠错与 GPU 融合研究取得进展。

IonQ 完成业界首个端到端实时量子纠错解码器测试。9 月 22 日，IonQ 宣布完成业界首个端到端实时量子纠错解码器测试，可使用单颗标准 CPU 在量子系统运行期间实时检测和纠正错误，测试覆盖最高 408 个逻辑量子比特和超 3100 万次量子操作。此举标志着量子纠错向实时化、实用化迈进，端到端实时纠错的实现为量子计算的规模化容错提供了基础能力。

IonQ 将在英伟达加速量子研究中心部署 Superion 256 量子计算机。9 月 23 日，IonQ 宣布将在英伟达加速量子研究中心部署 Superion 256 量子计算机，成为该中心首个现场部署的 QPU，并通过 NVQLink 连接英伟达 GB200 NVL72，开展量子计算与 GPU 融合研究。此举反映量子计算与经典 GPU 算力的融合探索加速，量子-经典混合计算的硬件协同路径逐步清晰。



2.6 下周关注重点

1）产业事件：阿里云栖大会后续发布与产业合作落地，平头哥真武 V900、倚天 CPU 的供应链配套进展；2）业绩与公告：光模块、存储、半导体设备等产业链公司三季报预告陆续披露；3）存储涨价：关注存储现货与长协价格走势、HBM 扩产节奏及玻璃基板等先进封装材料的配套进展；4）先进封装：京东方玻璃基封装载板、英伟达玻璃基板方案等新路线进展；5）海外产业：台积电晶圆代工涨价落地情况、CPO/NPO 光互联技术路线演进。

仅供内部参考，请勿外传

3. 风险提示

- AI 算力投资不及预期风险。
- 存储芯片价格波动。
- 中美贸易摩擦与出口管制加剧风险。
- 光互连技术路线切换不确定性风险。

仅供内部参考，请勿外传

研究团队简介：

李玖：北京大学光学博士，北京大学国家发展研究院经济学学士（双学位），电子科技大学本科，曾任华为海思高级工程师、光峰科技博士后研究员，具有三年产业经验，2019 年加入东北证券，现任电子行业首席分析师。

武芃睿：英国南安普顿大学光电研究中心硕士，华中科技大学光电信息本科，武汉大学工商管理学士（双学位）。曾任华为和上海微电子光电工程师，具有三年产业经验，2020 年加入东北证券，现任电子团队全球科技负责人。

叶怡豪：复旦大学保险学硕士，曾任职于东方财富证券，2025 年加入东北证券，现任电子行业分析师。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

股票投资评级说明	买入	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准： A 股市场以沪深 300 指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。	
	中性	未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。	
	减持	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。	
	卖出	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。	
行业投资评级说明	优于大势	未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内，行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场基准。	

仅供内部参考，请勿外传

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

东北证券股份有限公司

网址：http://www.nesc.cn 电话：95360,400-600-0686 研究所公众号：dbzqyanjiusuo

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630

